

化合物・酸化物ウェーハ用薄物両面研磨機

PH1500 / PH1800 Series

0.15 - 0.20mm 厚さのウェーハを50枚同時に加工

■ 特長

1. 業界初の高生産性
4 インチウェーハを一度に 50 枚以上の加工を実現できます。高生産性の両面研磨機です。
2. 高い信頼性
ウェーハの厚み 0.15 - 0.20mm を加工する場合のウェーハはみ出し等の問題を解決いたしました。
4way 4 モーターでの全軸同期制御
独自の上定盤懸架方式と加圧機構採用（日本特許取得）
3. アプリケーションの広さ
キャリアサイズを 10B ~ 26B（10 ~ 26 インチ径）迄選択できます。
4. ラップ機対応可能
5. 自動化対応可能
ワーク形状、研磨時間等のお客様のアプリケーションにより、自動化ラインを提案します。

■ 用途

1. ガリウム砒素、インジウムリン等の化合物半導体
2. リチウムタンタル、リチウムニオブ等の酸化物半導体
3. ガラス及び水晶等の電子部品材料

■ 概略仕様

1. キャリアサイズバリエーション（PH1800）

サイズ	搭載数	モジュール	定盤外径	定盤内径	サイズ	搭載数	モジュール	定盤外径	定盤内径
26B	5	2	1,810	510	16B	10	2.5	1,790	1,010
22B	6	2.5	1,790	700	14B	12	2	1,795	1,090
18B	8	2.5	1,790	910	12B	15	2	1,825	1,240

自動化: 8 もしくは 10 キャリアの場合、ローディング / アンローディング装置の組合せにより可能です。

2. 加工条件

4 軸サーボモーターによる 10 段プロファイルで多彩な加工条件の設定が可能です。

◆ 上定盤: 0.1 ~ 50rpm、下定盤: 0.1 ~ 50rpm、サンギア: 0.1 ~ 30rpm、インターナルギア: 0.1 ~ 15rpm

3. 上定盤懸架方式及び加圧機構（日本特許取得）

上定盤の加工圧及び熱変形（加工中の温度上昇等）に対して膨張収縮を拘束しない懸架方式と、荷重: 3 ~ 800kgf を越える最大荷重迄の設定に対して ± 2kgf 未満の精度で加圧ができます。

4. サイズ

L: 3.3m × W: 2.2m × H: 3.1m 重量: 約 12ton

その他、詳細仕様及び加工方法等に関しては、別途弊社迄お問い合わせ願います。



SSC システム精工株式会社

〒940 - 1164 新潟県長岡市南陽 2 丁目 951 番地 6 , E-mail: product@systemseiko.co.jp

Tel: 0258-22-1322. Fax: 0258-22-0185

神鋼商事

総販売代理店 / 神鋼商事株式会社 電子本部

〒103-8261 東京都中央区日本橋 1 丁目 2 番 5 号 (栄太楼ビル)

Tel: 03-3276-2398, Fax: 03-3276-3679, E-mail: Shinya.Yoshida@shinsho.co.jp